



HEAT SHIELDS



簡易、フレキシブルPCBリワーク向け 遮熱シールド

HeatShields™は、フレキシブルで高耐熱性材料のため、リワーク時の弱耐熱部品の保護に利用できます。耐熱性の低いコネクタ、バッテリーや電解キャパシタを、リワーク加熱エリアから保護します。セラミックベースの不織シールド材料が電子部品を長時間のリフロープロファイルによる熱から保護します。

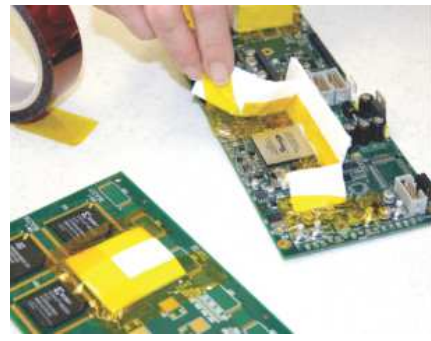
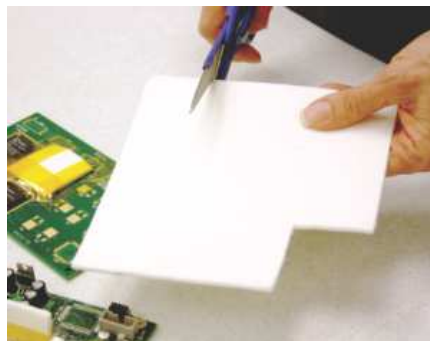


性能表

標準サイズ：610x610mm、3.2mm 厚
 1セットは、152 x 152mm口が2シート
 密度：10lb/cu.ft.(160.1kg/m³)
 引張強度：25PSI (3.87kg/m²)
 使用温度：1,800° F(982°C) 継続使用
 熱伝導性：

	BTU · in/hr · ft ² (w/m · k)
@500° F (260°C)	0.38(0.05)
@1000° F (537°C)	0.61(0.09)
@1500° F (815°C)	0.94(0.14)
@2000° F (1093°C)	1.40(0.20)

リワークや実装プロセス時における近接部品への熱影響により、周辺IC部品が再溶融してしまわないように保護する目的もあります。さらに、様々な形状に対応できるよう容易に加工できます。



デバイス信頼性を損なわないように熱源から部品を隔離します。

近接部品温度を約60度まで減少させ、対象部品は約35度まで低下させて、はんだ接合部を保護します。

輸入販売代理店：

株式会社シンアペックス

〒394-0004

長野県岡谷市神明町3-21-2

電子機器プロジェクト部門

TEL: 0266-22-9192

E-Mail: sales_e@shinapex.co.jp